

## 【採択事業一覧】

申請者	事業概要
<p>(株) アクシス (下関市)</p>	<p><b>【事業の名称】</b> AI向け半導体製造装置用高精度溶接技術の開発</p>
<p>《問い合わせ窓口》 代表取締役社長 古田 陽介 TEL : 083-288-2200</p>	<p><b>【事業内容】</b> 高精度かつ低歪みを、高速処理で実現する溶接技術を開発し、高性能化する半導体製造装置の品質向上を図る。</p>
<p>(有) 森板金 (萩市)</p>	<p><b>【事業の名称】</b> 県内半導体製造装置（エッチング装置）への参入のための面取り加工の技術開発による生産性の高い一貫生産体制の構築</p>
<p>《問い合わせ窓口》 執行役員 加藤 正雄 TEL : 0838-55-5522</p>	<p><b>【事業内容】</b> 手作業の多い面取り加工の「標準化」及び「高度化」技術を開発し、半導体製造装置における精密板金部品供給への本格参入を実現する。</p>
<p>(株) 吉田SKT (美祢市)</p>	<p><b>【事業の名称】</b> 半導体製造装置向け高度塗装技術の開発</p>
<p>《問い合わせ窓口》 製造部 部長 森 一城 TEL : 0837-52-0811</p>	<p><b>【事業内容】</b> 塗布膜厚が均一で、異物混入が無い塗装技術、及び、その自動塗布装置を開発し、半導体製造装置向け部品の表面処理の高機能化を図る。</p>